【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】令和6年4月4日(2024.4.4)

【国際公開番号】WO2023/281983
【出願番号】特願2023-533481(P2023-533481)
【国際特許分類】
H01M 50/533(2021.01)
H01M 10/04(2006.01)
H01M 10/0587(2010.01)
H01M 50/545(2021.01)
H01M 50/56(2021.01)
H01M 50/536(2021.01)
【FI】
H01M 50/533
H01M 10/04 W
H01M 10/0587
H01M 50/545
H01M 50/56
H01M 50/536

【手続補正書】
【提出日】令和5年12月6日(2023.12.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
一体構造５２は、環状であり、図３の平面図において、突出部５６の頂部５６ａと溝部５７の溝底５７ｂの夫々は、平板部５３の中心を中心とする円形状を有する。このため、芯体接合部を構成する突条部５１ａの上面５１ｂが、一体構造５２に径方向に対向する対向部５１ｃを含む。なお、平板部は、軸方向に略直交する底面を有していれば如何なる形状でもよく、また、径方向延在部は、突条部及び溝部を有さなくてもよい。また、径方向延在部は、円環形状でもよい。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
図７は、その結果を示すグラフである。図７に示すように、一体構造を有さない下側集電板を用いた場合、各電極体の孔径が６割程度まで縮小する一方、一体構造を有する下側集電板を用いた場合、電極体の孔径の縮小を良好な溶接を実現できる７割よりも大きい９割程度にできた。したがって、本開示の下側集電板の一体構造が負極芯体露出部の内倒れを抑制でき、良好な溶接を実現できることを確認できた。